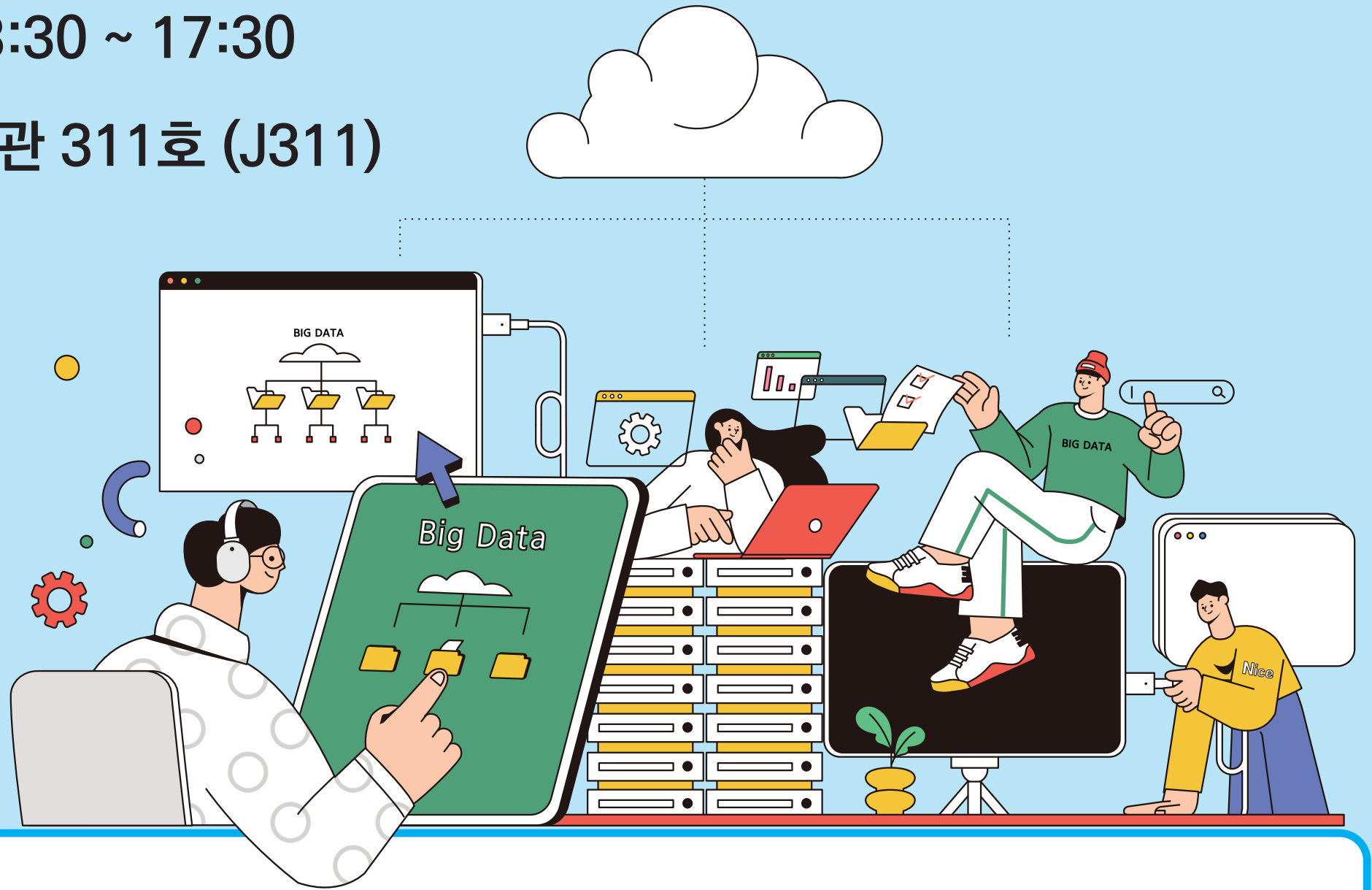


대규모 데이터센터 기술 동향 및 응용 세미나

[일 시] 2024.2.28(수) 13:30 ~ 17:30

[장 소] 서강대학교 정하상관 311호 (J311)




Schedule

| | |
|---|---|
| 1부 13:30~14:10(40분) | 인사말 및 현황 소개 |
| 2부 14:10~15:00(50분) 나승주 상무 (Intel Korea) | Session 1 : AI 발전 과반도체 공정, 패키징 기술 업계에서 가장 뜨거운 화두는 AI, 반도체 공정 및 패키징 기술이다. 대규모 AI 모델에 집중되었던 것에서 하이브리드 AI로 발전하고, 폭증하는 컴퓨팅 요구를 맞추고 아키텍처의 변화에 발맞추기 위한 공정기술의 발전 및 패키징 기술 발전이 빠르게 진화되고 있다. 미래 AI 및 반도체 공정, 패키징 기술 발전을 소개하고자 함. |
| 15:00~15:10(10분) | Break |
| 15:10~16:00(50분) 유충근 상무 (HPE Korea) | Session 2 : Accelerated Computing in HPC & AI HPC & AI 분야에서 다루는 문제의 크기와 복잡성이 증가되면서 Accelerated Computing 기술이 빠르게 발전하고 있습니다. 이 세션에서는 Accelerated Computing의 적용분야 및 사례를 소개하고 Accelerator의 개발 동향 및 요구조건에 대해서 소개하고자 함. |
| 16:00~16:50(50분) 삼성전자 | Session 3 : Data Center Technical Trends 데이터센터는 IT 관련 최신 기술인 Cloud, AI, Big Data 그리고 SNS 서비스 등의 4차 산업 혁명에 물리적으로 가장 기반이 되는 인프라임. 데이터센터의 개념 설명을 통하여 이해도를 높이고 구축 사례, 구성요소, 그리고 High Performance Computing에 필요한 미래 기술을 소개하고자 함. |
| 3부 16:50~17:20(30분) | 사진 촬영 및 석식 이동 |

Instructors

Intel Korea 나승주 상무, HPE Korea 유충근 상무, 삼성전자

[주 최]  BK21 Four 미래 두뇌모방 지능형시스템반도체 혁신인재양성 사업단
대규모데이터센터용 인공지능시스템반도체 연구센터